

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，对 2024 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况并分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队，对 2024 年度公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2024 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司董事 2025 年度薪酬方案》。2025 年度，公司董事（不含独立董事）除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬。公司独立董事领取固定津贴，2025 年度津贴标准为人民币 8 万元（税前），按月平均发放。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。2025 年度，公司高级管理人员薪酬同岗位薪酬。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

本公司审计委员会主任孙晓伟先生代表审计委员会全体委员，对 2024 年度审计委员会履行职责的情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，董事会对公司独立董事的独立性进行了核查：经核查独立董事孙晓伟先生、李治国先生、石建宾先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十一）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年的内部控制有效性进行了评价，并出具了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2024 年度外部审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘容诚所作为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计，聘期为一年。公司聘任容诚所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚所协商确定。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 16,602,289.07 元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

（十五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经容诚所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 78,481,491.79 元，其中母公司实现净利润 84,148,833.64 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 441,139,393.32 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.70

元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。公司以截至 2025 年 3 月 18 日的总股本 60,000,000 股，扣除截至 2025 年 3 月 18 日公司回购专用证券账户的股份 1,734,770 股后的 58,265,230 股为基数测算，公司拟合计派发的现金分红总金额为 9,905,089.10 元（含税）。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日